

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

沪士电子股份有限公司投资者活动记录表

编号：2023-0726-036

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 其他：_____ |
| 参与单位名称 | 国元证券股份有限公司、华富基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、睿亿投资、泰康资产管理有限责任公司、平安资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、尚峰资本管理有限公司、复胜资产、中信证券股份有限公司、开源证券股份有限公司 |
| 时间 | 2023年7月26日 10:00-11:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 公司接待人员 | 钱元君 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、行业情况</p> <p>出于对全球通货膨胀和经济衰退等因素的担忧，面对全球经济前景疲软，展望2023年PCB行业或将面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战，多重因素的冲击大幅抑制2023年上半年PCB行业的新增需求，直到2023年底和2024年的经济形势复苏。</p> <p>但从中长期来看未来全球PCB行业仍将呈现增长的趋势，Prismark预测2022-2027年全球PCB产值复合增长率约为3.8%，2027年全球PCB产值将达到约983.88亿美元。中国将继续保持行业的主导制造中心地位，但由于中国PCB行业的产品结构和一些生产转移，Prismark预测2022-2027年中国PCB产值复合增长率约为3.3%，略低于全球，预计到2027年中国PCB产值将达到约511.33亿美元</p> <p>(1) 企业通讯市场板业务情况</p> <p>全球经济增长预期放缓以及通胀压力引发了对企业通讯市场需求水平的可持续性的担忧，促使客户开始缩减先前因避免缺料等风险普遍建立的高库存。随着美联储的加息周期推进，企业通讯市场2023年上半年趋向保守，整体</p> |

新增订单疲软。经济环境的不确定性提高，将会进一步加剧企业通讯市场的需求波动。

从中长期看，全球范围内大型云服务和互联网厂商对数据中心基础设施的投资不会停滞，云计算、大数据、超高清视频、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用和发展将促使全球数字化转型，并进一步放大了网络的重要性，加快了数字化转型的进程。这将加速更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代，相关的路由器、数据存储、AI加速计算服务器产品也有望高速增长，催生对大尺寸、高层数、高阶HDI以及高频高速PCB产品的强劲需求，并对其技术层次和品质提出更高的要求。

在具体产品方面，应用于EGS级服务器领域的产品已具备规模化量产能力；在HPC领域，公司布局通用计算，应用于AI加速、Graphics的产品，应用于GPU、OAM、FPGA等加速模块类的产品以及应用于UBB、BaseBoard的产品已批量出货，目前正在预研应用于UBB2.0、OAM2.0的产品；在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G(基于56Gbps速率，25.6T芯片)的产品已批量生产，应用于800G(基于112Gbps速率，51.2T芯片)的产品已实现小批量的交付；基于数据中心加速模块的多阶HDI Interposer产品，已实现4阶HDI的产品化，目前在预研6阶HDI产品，同时基于交换、路由的NPO/CPO架构的Interposer产品也同步开始预研。

公司也将坚持以技术创新和产品升级为内核，持续加大在技术和创新方面的投资，通过深度参与客户产品的预研和开发，准确把握未来的产品与技术方向，进行新技术新工艺的研发，储备关键核心技术，以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。

(2) 汽车板业务情况

在汽车电子趋势变化的驱动下，2023年全球汽车市场预计仍将继续呈现稳中向好的发展态势，相关产品的结构性需求也有望呈现出显著的增长潜力。2023年初公司使用自有资金向沪利微电增资约7.76亿人民币，沪利微电将有针对性地加速投资，有效扩充汽车高阶HDI产能。胜伟策已成为公司的控股子公司，公司将加快p²Pack技术开发与市场推广。一方面尽快完成胜伟策应用于48V轻混系统的样品测试与客户认证，争取在2023年第四季度实现量产；另一方面

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>通过和产业链合作伙伴的深度合作，加快推进应用于800V高压架构的产品技术优化和转移，推动采用p²Pack技术的产品在纯电动汽车驱动系统等方面的商业化应用。在p²Pack技术开发与市场推广期间，全面推进胜伟策与公司在汽车应用领域的核心业务协同整合，采取有效措施改善其财务结构，降低其利息负担；实施精益管理，使其达成降本增效；借助公司、Schweizer、胜伟策在汽车应用领域的优势技术能力，优化市场布局，以充分利用胜伟策现有产能，最大幅度的缩减胜伟策亏损额。</p> <p style="text-align: center;">二、海外基地进展情况</p> <p>由于海外客户更加关注并加强地缘供应链风险分散战略的实施，多区域分散风险运营能力或将逐步成为行业未来成长的关键，公司已购买位于泰国洛加纳大城工业园区内的面积约201,846.8平方米的土地，以满足公司泰国子公司未来项目建设需求。公司将加速泰国生产基地的进程，并已启动基建，力争将其实现规模量产的规划，从2025年上半年提前到2024年第四季度。</p> <p style="text-align: center;">三、汇率波动的影响</p> <p>公司2022年度外销收入占比超过70%，公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感，美元升值对公司汇兑收益有正向影响，整体公司依然主要采用合理安排外币结构和数量、平衡外币收支的方法来控制汇率风险，并根据汇率市场走势安排外币存贷款的期限结构，适当开展外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险。</p> <p style="text-align: center;">注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2023年7月26日 |